

EPP

ELEKTRONIK PRODUKTION & PRÜFTECHNIK

11

NOVEMBER 2013



Baugruppenfertigung

Unterbrechungsfrei im Kundentakt

Packaging

Vergussmassen für die Mikroelektronik

Test & QS

Software zur Automatisierung manueller Prozesse

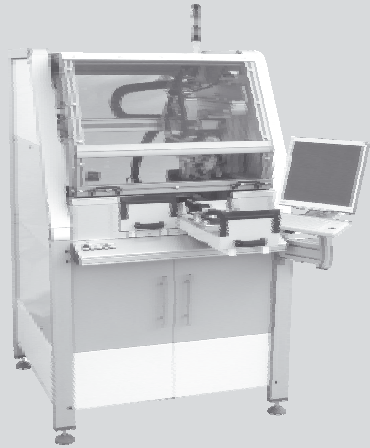
EMS-Dienstleister als Pionier der 3D AOI Messung

productronica 2013
München

Besuchen Sie uns:
Stand A2.281

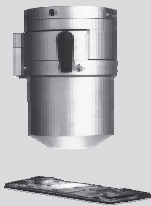
ATN

Lötroboter und Dosiertechnik



Roboterlöten mit:

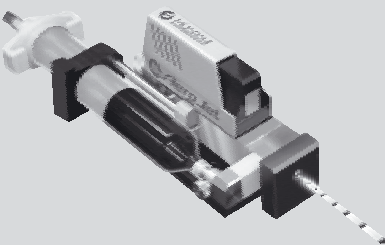
- Induktion
- Laser
- Licht
- Kolben
- Flamme
- Miniwelle



Dosiertechnik:

- Jetten
- Dispensen
- Sprühen
- Fluxen
- Coating

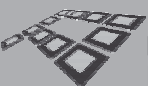
NEU: Jetten von Lotpaste



Autorisierter Vertriebspartner von:



Wir stellen aus:



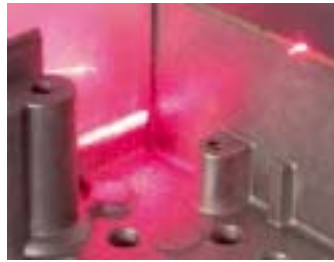
productronica 2013
Halle A3 Stand 447

www.atn-berlin.de

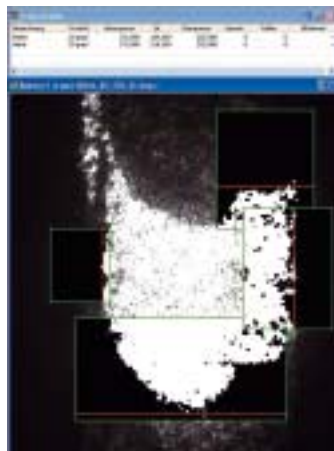
Innovatives 3D-Messverfahren für Flüssigdichtungen und Klebeverbindungen

Dosiertechnik Kübler präsentiert die völlig neu entwickelte 3D-Kameraüberwachungseinheit als Applikation für das hochflexible Dosiersystem Dos.Flex. Mit dieser neuen Technologie der Raupenvermessung wird das Auftragen der Dichtungsschnur revolutioniert werden. Erstmals wurde ein Live-Time Eingriff in den Fertigungsprozess realisiert, der sich entsprechend der Toleranzen in Echtzeit anpasst. Hierdurch hat der Anwender erstmalig die Möglichkeit, den Ausschuss aufgrund der Toleranzen auf ein Minimum zu reduzieren.

Die letztjährig auf der Bondexpo vorgestellte Dos.Flex Maschine zählt mit den Linearmotorenachsen und einer Verfahrgeschwindigkeit von 1 000mm/sec bei 20µ (+/- 0,02mm) Positionsgenauigkeit zu den schnellsten Dosieranlagen auf dem Dispensermarkt. Zu dem bereits bestehenden, umfangreichen und komfortablen Dosierzubehör wurde ein völlig neuartiges Messprinzip entwickelt, um die Qualität der Produkte entscheidend zu verbessern. Die Messung erfolgt im



Die Laserline rechts oben im Bild stellt die Geometrie der Dispenserraupe dar



Die Messung erfolgt im dynamischen Prozess, beide Messergebnisse können in einem geschlossenen Regelkreis das Volumen im Nachhinein regulieren

dynamischen Prozess – also ein völlig neuartiges, bisher noch nicht auf dem Markt befindliches Messverfahren. Mit dieser Neuentwicklung wird die Oberflächenstruktur der Dichtungsschnur und des Werkstücks in X, Y und Z-Richtung erkannt und bewertet. Dies führt zu einem entscheidenden Vorteil: im Automobilbereich wird bei kritischen Bauteilen eine 100%ige Kontrolle gefordert – dies ist mit dem neuartigen Messverfahren gewährleistet.

Die Vorteile im Überblick:

- Minimierung der Ausschussraten durch die Qualitätsverbesserung im Prozess.
- Schaffung der ersten 3D-Inline Serienüberwachung – genügen auch den Anforderungen der Automobilindustrie.
- Kostengünstiges System zur 100% Überwachung.
- Gute Planarität ermöglicht ein optimales Dichtungssystem.
- Zur eigentlichen Konturkontrolle und Dichtungsüberwachung ist zur Gesamtlösung die Traceability (Rückverfolgung) möglich.

www.kuebler-ht.de

Leistungsstarke Inspektionssysteme mit fortschrittlichen Features

Mirtec präsentiert seine preisgekrönten 3D AOI und SPI Inspektionssysteme auf der productronica in München. Die MV-9 2D/3D In-Line AOI Maschine ist ausgerüstet mit der Omni-Vision 3D Inspektionstechnologie des Unternehmens, die das 25 Mega Pixel 2D Isis Vision System mit dem digitalen Multifrequenz Quad Moiré 3D System kombiniert, um auf fertigen Leiterplatten eine Präzisionsinspektion von SMT-Bauelementen zu gewährleisten. Das neue Modell kann durch den Einsatz von Standardlinsen die Inspektionszeiten erheblich verbessern. Das 3D SPI System mit den höchsten Anforderungen, MS-15, ist mit 25 Mega Pixel Kameras und der detailgenauen 7,7µm Linse und dem Hochgeschwindigkeits-Datentransfer

CoaXPress ausgerüstet, um schnelle und exakte SPI Inspektion zu gewährleisten und beinhaltet schattenfreie Doppelsonden 3D sowie Laser Anti-Warpage. MV-7xi In-Line AOI System ist mit dem 10 Mega Pixel Isis Vision System ausgestattet. Dieses optische System umfasst eine 10 Mega Pixel Top-Down-Kamera und eine 13,4 Mikron telezentrische Präzisions-Verbundlinse. Das MV-3L AOI Tisch-System ist das am meisten akzeptierte Fünf-Kamera AOI-Tisch-System. Das System ist mit einer 10 Mega Pixel Top-Down Kamera, einer 13,4 Mikron telezentrische Präzisions-Verbundlinse und vier 10 Mega Pixel Side-View Kameras ausgestattet. Es enthält ebenfalls das Intelli-Beam Laser System. Diese fortschrittliche Technik bietet



vier Punkte Höhenmessung für den Koplanaritätstest von BGAs und CSPs und verbesserte Lotpastenmessung.

Productronica, Stand A2.578

www.mirtec.com